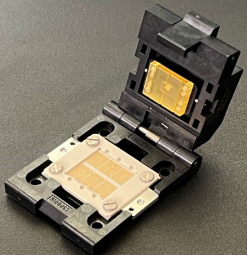
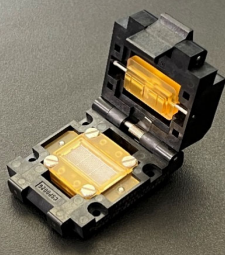
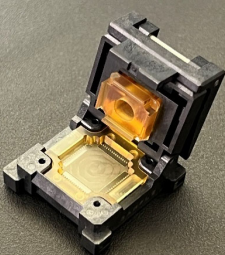


セミカスタム IC ソケット 一覧

 KASASAKU ELECTRONICS CO.,LTD.			
製品名	001G	002G	004G
ソケット外形寸法	48mm×36mm	41mm×31mm	26.5mm×26.5mm
IC押さえ機構	クラムシェルタイプ		
特長	大型ICや多ピンICの測定に対応し、広い内部スペースを活かして電氣的・機械的要件に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。	多くのお客様に採用されている実績豊富なサイズで、多品種少量生産から開発、各種検査環境まで、柔軟なカスタマイズが可能です。	002Gの特長を継承しながら、小型ICや省スペースでの使用に最適です。
実装できるICの最大外形寸法 *1	最大寸法 19mm × 15mm	最大寸法 16mm × 9mm	最大寸法 12mm × 12mm
対応ICパッケージ	QFP、QFN、BGA、LGA、SOT、SOP、SON、CSP、FET、MOSFET		
対応ピッチ	0.25mmピッチ～ ※不等、自由なピン配置が可能です。		
対応ピン数	19mm×15mm以内のエリアであれば、自由な位置にピンを配置することが可能です。	16mm×9mm以内のエリアであれば、自由な位置にピンを配置することが可能です。	12mm×12mm以内のエリアであれば、自由な位置にピンを配置することが可能です。
参考対応ピン数例	ピッチ0.4mm時：1360ピン（40×34） ピッチ0.5mm時：891ピン（33×27）	ピッチ0.4mm時：760ピン（38×20） ピッチ0.5mm時：527ピン（31×17）	ピッチ0.4mm時：324ピン（18×18） ピッチ0.5mm時：361ピン（19×19）
コンタクトピン	スプリングブローブピン、板バネピン		
耐熱温度	-55℃～ +180℃		
納期(受注後) *2	最短実働8日～		

*1.ICのサイズにつきましてはご相談ください。

*2.仕様と数量により変動がございます。